

EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform – November 8, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. Company executives will be available to discuss the next-generation EVG150 resist processing system. Company executives will be available to discuss the next-generation EVG150 resist processing system at SEMICON Europa, taking place next week at the Messe München in Munich, Germany, from November 15-18 (co-located with Electronica). “Through our cooperative research with leading manufacturers, we develop key technologies that build the foundation for Industry 4.0, IoT, autonomous driving, CPS, AI, smart cities, smart energy, and smart health long before they reach the market.” stated Dr. Mohssen Moridi, Head of Research Division Microsystems of Silicon Austria Labs.



새로워진 디자인의 200mm 플랫폼으로 이전 세대 플랫폼의 우수한 성능은 그대로 유지
 모듈 용량을 늘려 생산성을 높이고 아키텍처 개선을 통해 장비 풋프린트 축소



MEMS, 나노기술 반도체 시장용 웨이퍼 본질과 리소그래피 장비 분야 전문 회사인 EV Group(EVG)은 최근 자사의 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 차세대 200mm 제품인 EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시했다고 밝혔다. 사진=EV Group



- 최신뉴스
- 대한항공, 도입
 - [글로벌 AI] AI
 - 트랜스퍼블리저
 - 인라이플, 시공
 - 기술 속에 저

[비즈월드] MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩과 리소그래피 장비 분야 전문 회사인 'EV Group(이하 EVG)'은 최근 자사의 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 자세대 200mm 제품인 'EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템'을 출시했다고 밝혔다.

새로운 디자인의 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼과 비교해서 최대 80%까지 더 높은 생산성, 우수한 범용성, 50% 더 작은 풋프린트가 특징이라고 업체 측은 설명했다.

범용 플랫폼으로서 신뢰할 수 있는 고품질 코팅과 현상 공정을 가능하게 해 절단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스와 애플리케이션에 적용할 수 있다고 한다. 새로운 장비는 우수한 생산성과 유연성, 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다는 것이다.

오는 11월 15일부터 18일(현지 시각)까지 나흘간 독일 뮌헨의 메세 뮌헨에서 개최되는 세미나 유로파(SEMICON Europe) 전시회에서 EVG 부스를 방문하면 EVG의 임직원들로부터 직접 자세대 EVG150 레지스트 처리 시스템에 관한 설명을 들을 수 있다고 업체 관계자는 설명했다.

세계적인 EBS(electronic based system) 연구센터인 실리콘 오스트리아 랩스(Silicon Austria Labs)는 자세대 EVG150 시스템의 첫 번째 고객이다.

실리콘 오스트리아 랩스의 마이크로시스템 연구 부문장인 모센 모리디(Mohssen Moridi) 박사는 "우리는 선도적인 제조회사들과 협력해서 인더스트리 4.0, 사물 인터넷(IoT), 자율 운전, 사이버-물리 시스템(CPS), 인공지능(AI), 스마트 시티, 스마트 에너지, 스마트 의료의 토대를 마련하는 기술들을 개발하고 있다"면서 "EVG의 자세대 EVG150 레지스트 처리 시스템은 유연성이 뛰어나 EBS 혁신을 촉진하는 우리의 개발 고객들과 함께 새로운 공정과 제품의 대규모 구현을 위한 발판을 마련하는 데 도움을 준다"라고 말했다.

200mm 기반용 자세대 EVG150은 이전 세대 플랫폼의 업계 선도적인 특성을 그대로 유지하고 있다. 이런 특성으로는 ▲회전 및 분사 코팅, 현상, 베이킹 및 냉각 공정을 위해 맞춤형 모듈 구성이 가능한 완벽하게 자동화된 플랫폼 ▲극히 복잡한 형태의 컨포컬 코팅이 가능한 EVG 고유의 OmniSpray 기술 ▲지속적으로 높은 생산성을 달성하도록 듀얼 엔드 이력터 기능을 사용하는 정교하고 성능이 검증된 로봇 핸들링 그리고 ▲웨이퍼 예지 핸들링과 회거나 뒤롤린 웨이퍼, 또는 박막 웨이퍼를 취급할 수 있는 능력 등이 포함된다.

자세대 EVG150 200mm 플랫폼은 최대 4개의 습식 처리 모듈 공간과 최대 20개의 베이킹/냉각 유닛을 제공해 여러 웨이퍼를 동시에 처리 가능, 코팅 챔버들을 분리시킴으로써 모듈들을 완벽하게 격리시키고, 모듈 간의 교차 오염을 실질적으로 제거, 디자인을 개선해 장비 바깥에서 개별 챔버에 쉽게 접근할 수 있다.

이를 통해 챔버 유지보수 작업 때 가동 중단 시간을 최소화하고 계속해서 장비 가동 가능, 챔버들의 위치를 변경해서 로봇 핸들링 유닛에 용이하게 접근할 수 있으므로 수월하게 유지보수 가능, 이미지 기반의 프리알라이너(pre-aligner)를 사용해서 신속히 웨이퍼 센터링이 가능하게 한다.

이런 효과로 처리 시간을 단축하고 시스템 내에 레지스트와 화학물질 라인을 통합함으로써 화학물질 저장에 위한 외부 캐비닛 공간 절약, 장비 풋프린트 축소, 시스템 내에 사용자 인터페이스를 통합해 장비 풋프린트를 더욱 축소 등의 특징을 가진다고 업체 관계자는 강조했다.

EVG의 기업 테크놀로지 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "레지스트와 패터닝 공정은 반도체 제조에 있어서 가장 반복적으로 사용되는 공정들이다. EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 고객들의 극히 까다로운 요구를 충족하는 솔루션을 제공한다"면서 "자세대 EVG150 시스템은 이런 경험을 토대로 탄생한 것으로, 범용 플랫폼으로 새로운 자원의 생산성과 비용 상의 이점을 달성하도록 설계됐으며 전례 없이 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 충족한다"라고 말했다.

한편 자세대 EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템은 현재 장비 주문이 가능하며, EVG 본사에서 제품 데모를 진행하고 있다고 전했다.



비즈월드단!

1 [단독] 오부
은 채우부

<http://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=44921>